

2025年度 (2026年3月期) 第2四半期決算説明会

2025/11/04

株式会社東京精密

代表取締役社長CEO

取締役 半導体社 執行役員カンパニー長

計測社 執行役員カンパニー長

執行役員常務 CFO

木村 龍一

伯耆田 貴浩

石川 一政

小泉 公人

- ・ **将来の事象に係わる記述に関する注意：** 本資料に記載されている情報、ならびに口頭で提供される情報は、現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。これらは、市況、競争状況、半導体業界、ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。
- ・ **用語について：** 注記がある場合を除き、半導体製造装置セグメントを「半導体」、精密計測機器セグメントを「計測」、また親会社株主に帰属する当期純利益を「当期純利益」と記載します。
- ・ **記入データについて：** 記載されている金額や比率の情報は「億円」、またはパーセント(%)による要約表示を行っております。その為、内訳の計が合計と一致しない場合があります。
- ・ **監査について：** 本プレゼンテーション資料は、監査法人による監査の対象外です。

エグゼクティブサマリー

2025年度上期 業績	<ul style="list-style-type: none">売上高は771億円(前年同期比+8%, 上期既往ピーク)、営業増益の着地半導体で、期ずれを想定したHBM向け案件の受注を獲得特別損失を計上した結果、純利益は96億円(減益)
下期 事業環境	<ul style="list-style-type: none">半導体は、引き続きHPC関連・中国向けハイエンド需要に期待計測では航空宇宙・防衛関連の需要に期待
2025年度通期 業績予想	<ul style="list-style-type: none">上期受注高が想定を上振れたことを主因に、売上高予想 +50億円修正研究開発費・設備投資計画も変更年間配当予想を変更 (214円/株 → 222円/株)

- 代表取締役社長CEOの木村です。
本日はご多忙のところ、ご参加いただきまして 厚く御礼申し上げます。
- まず2ページ目は、本日の開示内容に関するエグゼクティブサマリーです。
- 上期の業績を総括すると、公表予想をやや下振れたものの、売上高は上期の既往ピークを更新、営業利益は増益の着地となりました。
- 受注は、期ずれを想定していたHBM向け受注が上期に獲得でき、想定を大幅に上振れました。一方、特別損失を計上した結果、純利益は減益となりました。
- 下期に向けては、半導体では引き続き 生成AIを含むHPC、中国向けハイエンドに加え、メモリ向けへの期待があるほか、計測では航空宇宙、防衛関連の需要に動きがあり、期待をしております。
- 通期業績予想ですが、上期受注が想定以上だったことを主因に、純利益を除き、上方修正しました。研究開発費及び、設備投資についても変更しております。
- また、年間配当予想を変更、増配といたしました。この変更は、特別損失が無かったものと仮定した配当性向を基にした修正です。配当予想の詳細については、本日発表した適時開示をご覧ください。

2025年度 上期 連結業績

売上高・各利益(純利益除く)・受注高 前年同期比で増加。特別損失(製品不具合対策費)21億円を計上

全社業績(億円)	2024年度上期	2024年度下期	2025年度上期	前半期比	前年同期比	
受注高	711	745	806	+8%	+13%	
売上高	714	791	771	-3%	+8%	
営業利益	134	163	147	-10%	+10%	
(利益率)	(19%)	(21%)	(19%)	-2pt	+0pt	
経常利益	132	168	150	-11%	+14%	
当期純利益	136	121	96	-20%	-29%	
研究開発費	51	53	55	+4%	+10%	
設備投資	40	63	69	+10%	+74%	
減価償却費	25	26	27	+1%	+8%	
セグメント別業績	2024年度上期	2024年度下期	2025年度上期	前半期比	前年同期比	
半導体 製造装置	受注高	517	560	613	+10%	+19%
	売上高	543	592	594	+0%	+9%
	営業利益	111	132	123	-6%	+11%
	(利益率)	(21%)	(22%)	(21%)	-2pt	+0pt
計測機器	受注高	194	185	193	+4%	-1%
	売上高	171	199	177	-11%	+3%
	営業利益	23	31	24	-24%	+5%
	(利益率)	(13%)	(16%)	(14%)	-2pt	+0pt

- 3ページは、2025年度上期の業績です。
- 上段ですが、売上高は、半導体を中心に増収、これにより営業利益・経常利益も増益の着地となりました。
- 売上高は、上期としての既往ピークとなりました。
- 純利益については、特別損失21億円を計上した結果、前年同期比で減益となりました。
- この特別損失ですが、半導体の検査装置、プローバの高精度温度技術に係るものです。一部の製品に不具合が確認され、その対応や、予防的措置に関する費用を、今回特別損失として計上いたしました。なお、この不具合については、すでに技術的な対応策が明確になっており、必要な対策を打っておりますので、将来の業績への影響は無いものと考えております。
- 受注面では、半導体、特にHBM向け案件の獲得で増加しました。

2025年度 第2四半期 連結業績

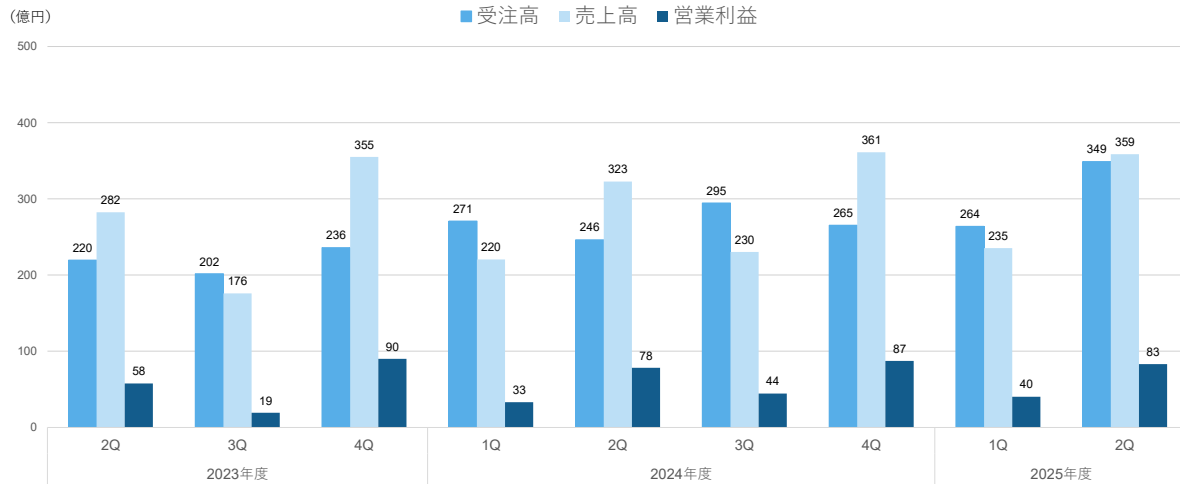
売上高・利益(純利益除く)・受注高 それぞれ前年同期比・前四半期比で増加

全社業績(億円)	2024-1Q	2024-2Q	2024-3Q	2024-4Q	2025-1Q	2025-2Q	前四半期比	前年同期比
受注高	374	337	392	353	359	447	+25%	+33%
売上高	296	418	317	474	309	462	+50%	+10%
営業利益	41	93	57	106	46	101	+121%	+9%
(利益率)	(14%)	(22%)	(18%)	(22%)	(15%)	(22%)	+7pt	+0pt
経常利益	43	88	66	101	45	105	+136%	+19%
当期純利益	36	100	46	75	32	64	+98%	-36%
研究開発費	23	28	25	28	25	30	+22%	+10%
設備投資	28	12	24	39	25	44	+76%	+274%
減価償却費	12	13	13	13	12	14	+16%	+13%
セグメント別業績	2024-1Q	2024-2Q	2024-3Q	2024-4Q	2025-1Q	2025-2Q	前四半期比	前年同期比
半導体 製造装置	受注高	271	246	295	265	349	+32%	+42%
	売上高	220	323	230	361	359	+52%	+11%
	営業利益	33	78	44	87	83	+106%	+6%
	(利益率)	(15%)	(24%)	(19%)	(24%)	(23%)	+6pt	-1pt
計測機器	受注高	103	91	98	87	98	+3%	+8%
	売上高	76	95	87	113	103	+41%	+8%
	営業利益	8	15	12	19	18	+234%	+23%
	(利益率)	(10%)	(16%)	(14%)	(17%)	(18%)	+10pt	+2pt

- 4ページは、四半期の業績推移となります。
- 第2四半期の実績は、売上、各利益、受注高 それぞれ前年同期比、前四半期比で概ね増加となりました。
- 次に、セグメント別に説明いたします。

半導体製造装置セグメント 業績推移

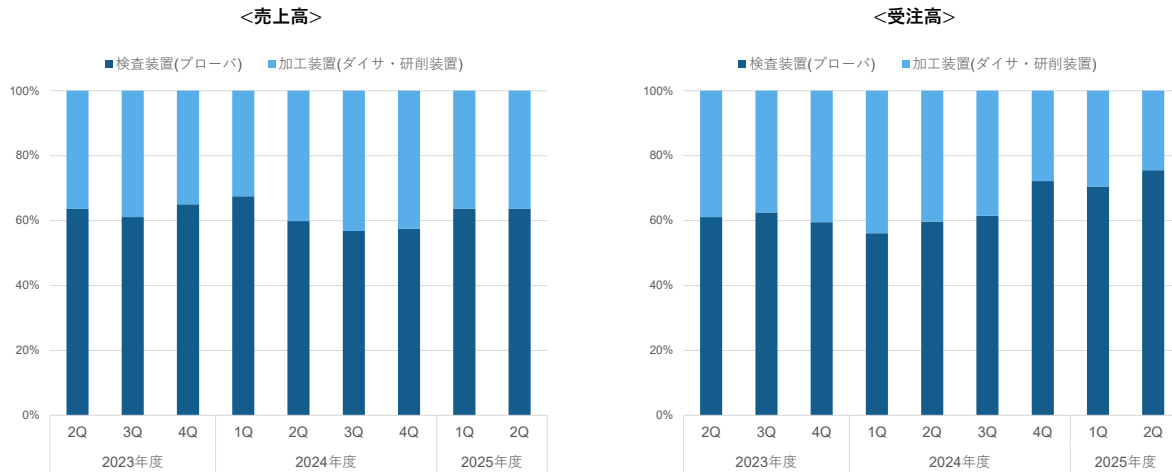
第2四半期の受注高は、期ずれを見込んだHBM案件を獲得できたことで、想定を大幅に上振れ
売上高は、台風の影響などの要因を受け、想定をやや下振れ



- 5ページは、半導体の受注高・売上高・営業利益の四半期推移をグラフで示したものです。
- この第2四半期の受注高は349億円となりました。
- 安定したHPC需要や中国でのハイエンド需要に加えて、期ずれを想定したHBM向けのプローバ受注を第2四半期に獲得できたことで、想定を大幅に上振れました。
- 売上高は、概ね計画通りでしたが、一部で台風による設置遅れなどがあり、想定をやや下振れました。

半導体製造装置セグメント 製品別構成比

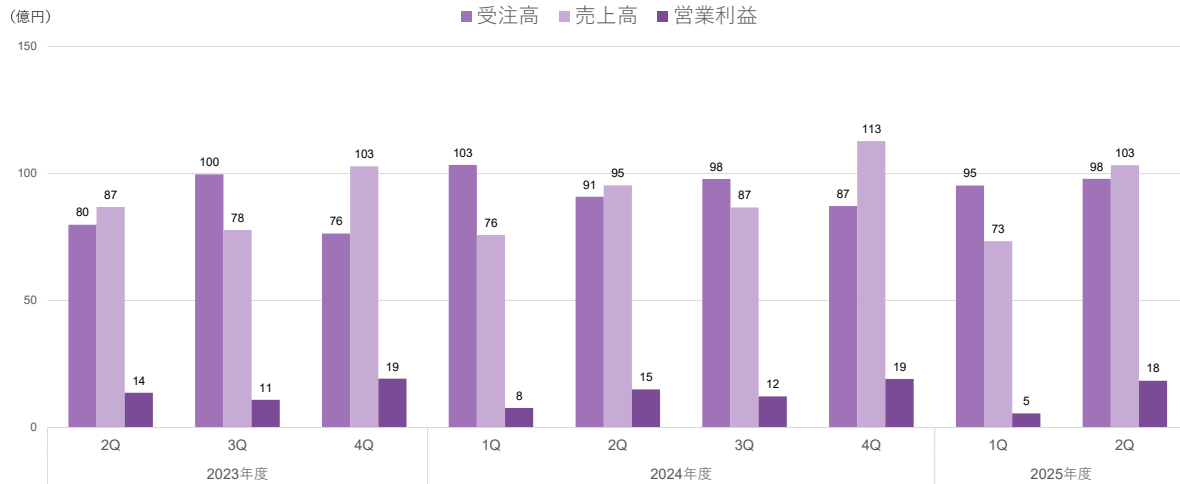
受注では、HBM向け受注を主因に、検査装置(プローバ)の構成比率が増加



- 6ページは、半導体の四半期受注高・売上高を装置別に示したものです。
- 右側、受注高ですが、第2四半期の検査装置、プローバの受注構成比は7割半ばとなりました。こちらは、先ほど説明したHBM向けの受注によるものです。

計測機器セグメント 業績推移

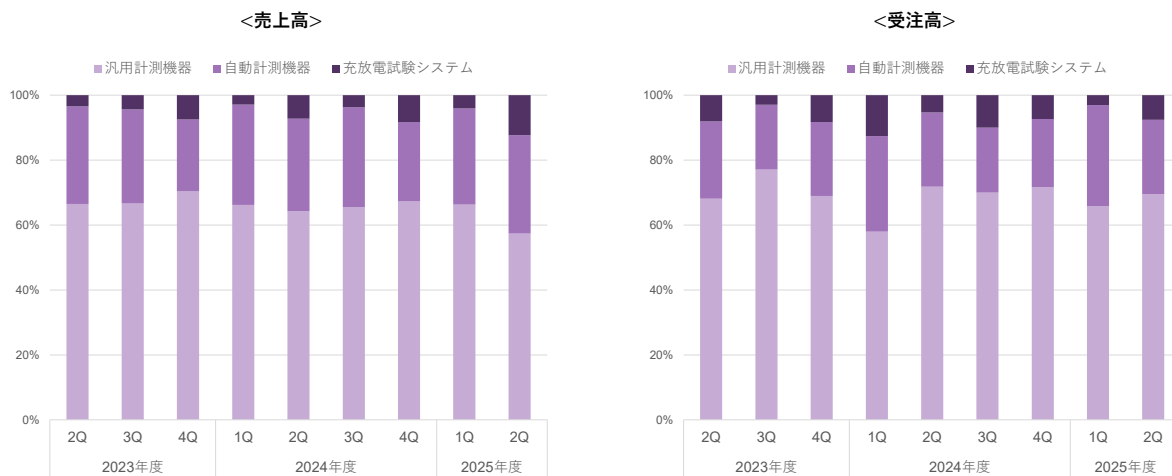
第2四半期の受注高は概ね想定内の着地(更新投資、航空宇宙・防衛関連需要が底堅く推移)
売上高は、概ね想定並みの着地



- 7ページは、計測の受注高・売上高・営業利益の四半期推移をグラフで示したものです。
- 第2四半期の受注高は98億円で、想定並みの着地となりました。
- 自動車・機械分野の新規需要は弱含んだ一方で、更新需要、航空宇宙・防衛分野などの業界向けの新規需要を獲得しました。また、第1四半期に関税影響を見定めていた顧客が、第2四半期に投資を再開したことで、通常の季節性にはない動きも見られました。
- 売上面では、概ね想定並みの着地となりました。

計測機器セグメント 製品別構成比

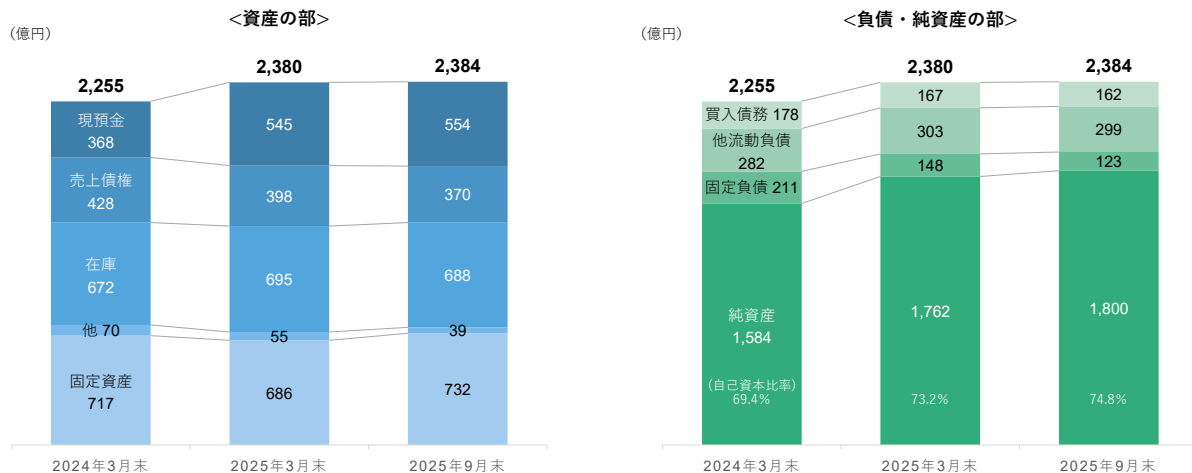
第2四半期は受注・売上ともに特筆すべき変化はない



- 8ページは、計測の四半期受注高・売上高を装置別に示したものです。
- 製品別動向は、多少のバラツキが見られますが、特筆すべき大きな変化は無いと考えています。

貸借対照表

固定資産が増加、売上債権が減少し、総資産は前期末比でほぼ横ばい

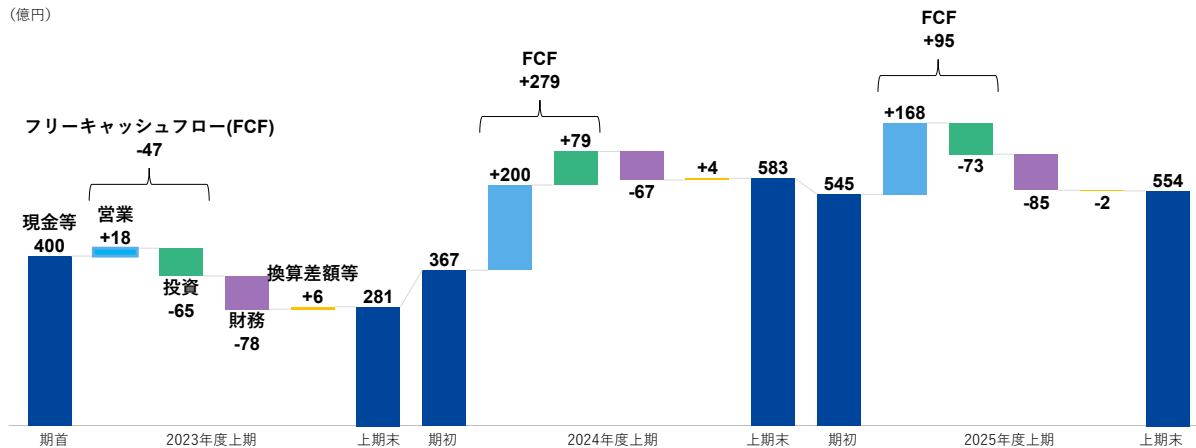


- 9ページは貸借対照表の説明です。
- 2025年9月末の総資産は、2,384億円となりました。
- 左側、資産の部ですが、愛知県 名古屋工場の竣工などを主因に固定資産が増加、売上債権が減少し、総資産は横ばいとなりました。
- 右側、負債・純資産の部については、借入金の返済が進み、負債が減少しました。
- 9月末の自己資本比率は 74.8%となりました。

キャッシュフロー

利益の計上を主因にFCFはプラス

(億円)



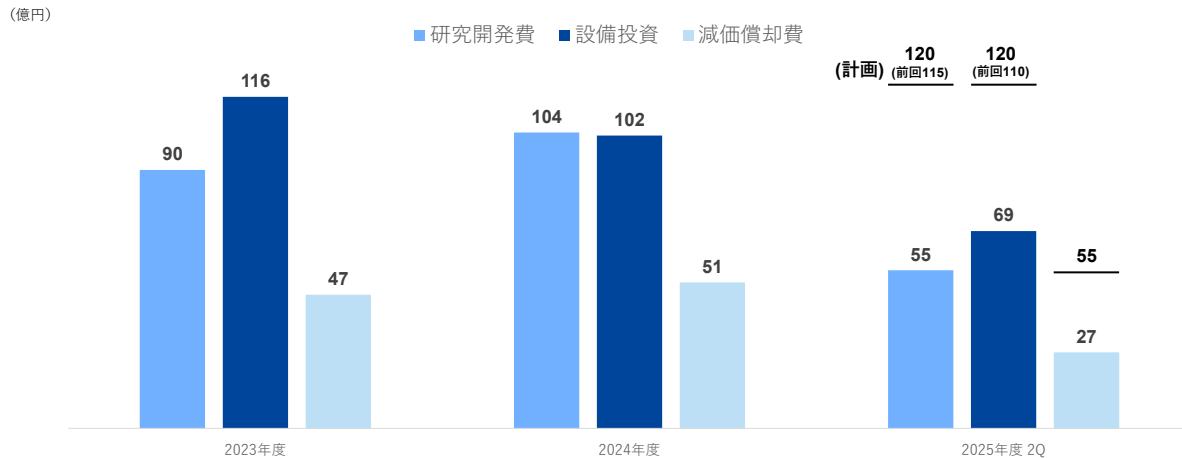
10 @ TOKYO SEIMITSU

ACCURETECH | 東京精密

- 10ページは上期のキャッシュフローの説明です。上期実績を3か年分並べています。
- この上期は、営業キャッシュフローは利益の計上を主因にプラス168億円、投資キャッシュフローがマイナス73億円となり、フリーキャッシュフローはプラス95億円となりました。
- 財務キャッシュフローは、配当金の支払い等によりマイナス85億円となり、上期末の現預金残高は554億円となりました。

研究開発費・設備投資・減価償却費

第2四半期までは概ね計画線の推移。研究開発費・設備投資計画を変更



11 @ TOKYO SEIMITSU

ACCURETECH | 東京精密

- 11ページは研究開発費、設備投資、減価償却費の実績です。
- 棒グラフが第2四半期までの実績となり、概ね想定通りの推移となりました。なお、名古屋工場が、この8月に竣工いたしました。
- 横線で示しているのが通期の計画となりますが、研究開発費は、開発強化のために5億円、設備投資は、特に検査装置の生産能力増強に向けた投資を積み増し、10億円 プラスしております。
- なお、現在、埼玉県飯能市にある工場の隣接地に、新たな土地を購入する計画があり、今年度の設備投資計画の見直しも検討しております。
- ここまでが、2025年度第2四半期の実績の説明となります。

2025年度通期業績予想の前提(青字:11月変更)

売上・営業利益

半導体：引き続き 生成AIを含むHPC案件の売上が貢献、上期受注高上振れにより8月計画比で増収を想定

- 生成AIを含むHPC：売上高・利益に占める割合は増加(4割程度)
- グローバルOSAT：HPC向けプローバの出荷増加を想定
- 中国需要：受注済案件の出荷・据付が計画通り続く
- HBMを除くメモリ：下期の出荷増加を想定

計測：高水準を維持、下期は特に航空宇宙・防衛関連が堅調

利益：引き続き 部材調達価格・経費等の上昇の影響を受ける

受注動向

半導体：HPC・中国ハイエンド向け需要が継続

- 生成AIを含むHPC：HBM、ロジック向け 共に上期並みの水準を想定
- グローバルOSAT：稼働率は回復傾向が続く
- 中国需要：HPCを含むハイエンド需要が継続すると想定
- HBMを除くメモリ：引合の増加を期待

計測：引き続き更新投資や充放電試験システムに加え、航空宇宙・防衛などの事業機会を捉える

- 12ページには、2025年度の通期業績予想の前提を示しております。青字が、8月の説明からの変更点です。
- 上段の、売上・利益の前提ですが、まず半導体では、上期の受注高が想定を上振れたため、前回予想より増収を想定しています。
- その中、生成AIを含むHPC向けの需要や、中国向け案件が、引き続き業績のけん引役になるほか、HBMを除くメモリ向けの出荷が増加すると考えています。
- 利益面では、引き続き、部材調達や経費増加のインパクトを受けており、原価低減活動を進めてまいります。
- 下段の、受注面では、半導体ではHPC向けや、中国ハイエンド需要の獲得を狙ってゆくほか、計測では、上期にも見られた、航空宇宙・防衛分野での事業機会を捉えていきたいと考えております。

2025年度通期業績予想

2025年8月4日に公表した通期業績予想・配当予想を修正

売上高・営業利益・経常利益は、半導体の受注上振れを主因に上方修正、純利益は特別損失を主因に下方修正

配当予想は、特別損失の影響を控除したものとして修正

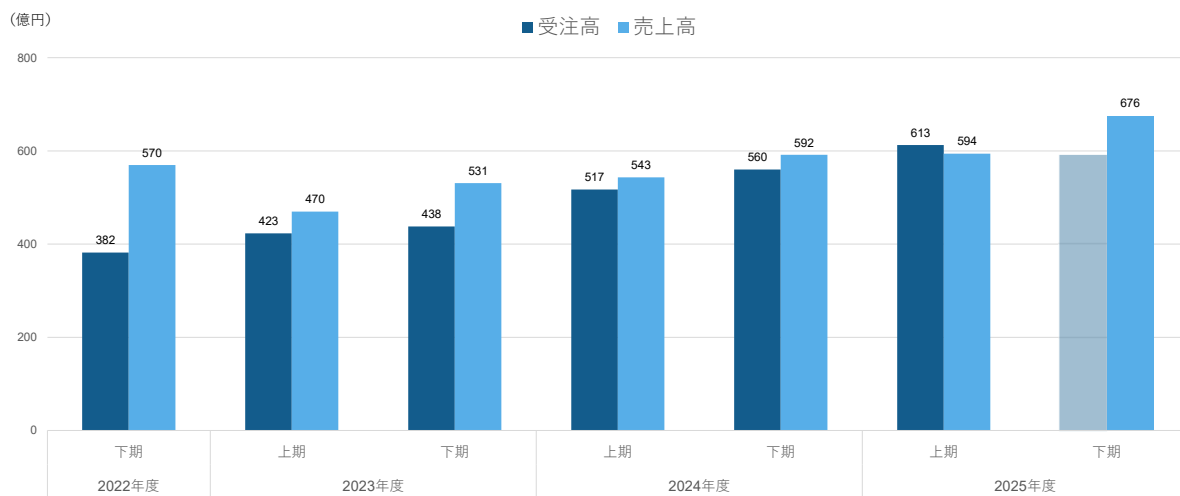
前提為替レートは140円/ドルを据え置き (為替変動影響は軽微：円建て比率高)

全社業績(億円)	2024年度上期	2024年度下期	2024年度通期	2025年度上期	2025年度下期予	2025年度通期予	前回予想比(通期)	前期比(通期)
受注高	711	745	1,456	806	-	-	-	
売上高	714	791	1,505	771	869	1,640	+50	+9%
営業利益	134	163	297	147	168	315	+5	+6%
(利益率)	(19%)	(21%)	(20%)	(19%)	(19%)	(19%)	±0pt	-0pt
経常利益	132	168	299	150	165	315	+5	+5%
当期純利益	136	121	256	96	109	205	-12	-20%
研究開発費	51	53	104	55	65	120	+5	+16%
設備投資	40	63	102	69	51	120	+10	+17%
減価償却費	25	26	51	27	28	55	±0	+8%
セグメント売上高	2024年度上期	2024年度下期	2024年度通期	2025年度上期	2025年度下期予	2025年度通期予	前回予想比(通期)	前期比(通期)
半導体製造装置	543	592	1,135	594	676	1,270	+50	+12%
計測機器	171	199	371	177	193	370	±0	-0%
1株配当(円)	114円	139円	253円	111円	111円	222円	+8円	-31円

- 13ページは、これらを踏まえた2025年度の業績予想の修正を説明しています。
- 8月予想に対し、売上高でプラス50億円、営業利益・経常利益はそれぞれプラス5億円 上方修正しました。これらは、いずれも半導体で受注が増加したことや、上期から後ずれとなった案件の獲得などが前提となっています。
- 純利益は、先ほど説明した特別損失の計上により下方修正となります。
- 研究開発及び、設備投資計画も、先程の説明通り、変更しております。
- なお、年間配当予想も変更し、本日 適時開示を行っております。配当予想は今回の純利益予想から、さらに特別損失の影響を控除したものと仮定し、当社の株主還元方針に併せて修正をしています。詳しくは、本日の適時開示資料をご覧ください。
- 前提為替レートは、1ドル 140円を据え置いております。現時点では、為替変動による業績への変動は軽微と見積もっております。

半導体製造装置セグメント- 売上・受注高 半期見込

2025年度下期受注高は前年同期比で微増を想定 (上期からの反動減もあり)



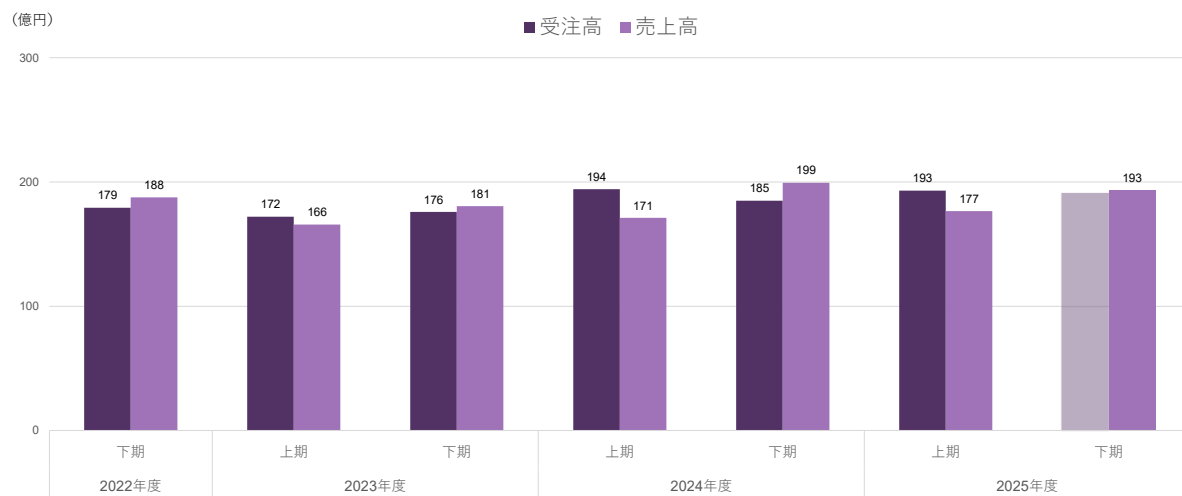
14 @ TOKYO SEIMITSU

ACCURETECH | 東京精密

- 14ページは、半導体事業の 売上高及び受注高の、半期ごとの見込みです。
- 25年度下期の受注高は、前年同期比で微増を想定しています。
- この上期比では減少の想定となりますが、上期受注が想定以上であったことの反動減であり、業容の変化は想定しておりません。引き続き、生成AIを含むHPC需要が中心となる想定です。
- 下期予想の製品構成比は、売上高は、検査装置 6割後半、加工装置3割前半、受注高は、検査装置 6割前半、加工装置3割後半を想定しています。

計測機器セグメント－売上・受注高 半期見込

2025年度下期受注高は前年同期比横ばいを想定



- 15ページは、計測事業の売上高及び受注高の、半期ごとの見込みです。
- 25年度下期の受注は、前年同期比で横ばいの想定です。
- 下期予想の製品構成比は売上高、受注高ともに、汎用計測 6割、自動計測が3割、残りが充放電試験システムの想定です。
- 以上で私からの説明を終わります。ご清聴 ありがとうございました。

質疑応答 / Q&A

Supplementary Data - セグメント別業績推移 / Segment Information

(百万円) Million Yen		会計期間 Fiscal Year				四半期 Quarter							
		2022年 3月期 FY2022/3	2023年 3月期 FY2023/3	2024年 3月期 FY2024/3	2025年 3月期 FY2025/3	2025年3月期 FY2025/3				2026年3月期 FY2026/3			
						1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
Oxide デバイス	半導体 SPE	152,896	99,366	86,082	107,713	27,081	24,631	29,456	26,544	26,378	34,945		
	計測 Metr.	33,159	36,960	34,802	37,917	10,336	9,082	9,781	8,717	9,523	9,786		
	合計 Total	186,056	136,326	120,885	145,631	37,417	33,713	39,237	35,262	35,901	44,732		
Backlog バックログ	半導体 SPE	102,370	89,371	75,398	69,630	80,433	72,785	79,205	69,630	72,466	71,541		
	計測 Metr.	9,904	12,428	12,606	13,470	15,362	14,911	16,031	13,470	15,660	15,123		
	合計 Total	112,274	101,799	88,004	83,101	95,796	87,697	95,236	83,101	88,127	86,664		
Sales 売上	半導体 SPE	101,145	112,365	100,055	113,481	22,046	32,280	23,036	36,118	23,542	35,870		
	計測 Metr.	29,556	34,436	34,624	37,053	7,580	9,532	8,661	11,278	7,333	10,323		
	合計 Total	130,702	146,801	134,680	150,534	29,626	41,812	31,698	47,397	30,876	46,194		
OP オペレーション	半導体 SPE	24,698	29,866	19,899	24,311	3,314	7,824	4,449	8,722	4,031	8,297		
	計測 Metr.	3,628	4,628	5,408	5,392	768	1,497	1,220	1,905	549	1,838		
	合計 Total	28,327	34,494	25,307	29,703	4,083	9,322	5,670	10,627	4,581	10,136		
Op Margin 営業利益率	半導体 SPE	24.4%	26.6%	19.9%	21.4%	15.0%	24.2%	19.3%	24.1%	17.1%	23.1%		
	計測 Metr.	12.3%	13.4%	15.6%	14.6%	10.1%	15.7%	14.1%	16.9%	7.5%	17.8%		
	合計 Total	21.7%	23.5%	18.8%	19.7%	13.8%	22.3%	17.9%	22.4%	14.8%	21.9%		

Supplementary Data - 損益計算書 / Income Statement

(百万円) Million Yen	会計期間 Fiscal Year				四半期 Quarter							
	2022年 3月期 FY2022/3	2023年 3月期 FY2023/3	2024年 3月期 FY2024/3	2025年 3月期 FY2025/3	2025年3月期 FY2025/3				2026年3月期 FY2026/3			
					1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
売上高 Net Sales	130,702	146,801	134,680	150,534	29,626	41,812	31,698	47,397	30,876	46,194		
売上原価 Cost of goods sold	77,694	84,967	79,917	88,081	17,753	24,757	17,960	27,609	18,468	27,411		
売上総利益 Gross Profit on Sales	53,008	61,834	54,762	62,453	11,873	17,054	13,738	19,787	12,407	18,783		
販売費および一般管理費 Selling, general and administrative expenses	24,681	27,339	29,454	32,750	7,790	7,732	8,067	9,159	7,825	8,647		
営業利益 Operating profit	28,327	34,494	25,307	29,703	4,083	9,322	5,670	10,627	4,581	10,136		
営業外収益 Non-operating income	987	965	1,404	921	287	39	539	55	133	309		
営業外費用 Non-operating expenses	153	162	259	684	41	531	-422	534	252	-69		
経常利益 Recurring Profit	29,160	35,297	26,453	29,939	4,329	8,829	6,632	10,148	4,462	10,515		
特別利益 Extraordinary gains	390	103	824	4,493	10	4,483	0	0	3	85		
特別損失 Extraordinary losses	34	2,099	21	158	-	-	157	0	-	2,103		
税引前利益 Profit before income taxes and minority interests	29,516	33,301	27,255	34,275	4,339	13,312	6,474	10,148	4,465	8,498		
法人税等合計 Total Income tax and others	8,132	9,607	7,791	8,531	754	3,310	1,870	2,596	1,228	2,090		
非支配株主に帰属する四半期純利益 Net Profit attributable to minority interests	57	62	84	106	31	6	29	39	7	25		
親会社株主に帰属する当期純利益 Net Profit attributable to Owners of the Parent	21,326	23,630	19,378	25,637	3,554	9,996	4,574	7,512	3,229	6,382		
1株当たり当期純利益(円) Net Profit per Share (Yen)	522.52	581.33	480.49	633.75	87.89	247.09	113.07	185.67	79.77	157.32		
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) Net Profit per Share (diluted) (Yen)	517.51	575.62	475.42	628.31	-	-	-	-	-	-		

Supplementary Data - 貸借対照表 / Balance Sheet

(百万円) (Million Yen)		2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期 FY2024/3	2025年3月期 FY2025/3	2026年3月期(2Q末) FY2026/3(2Q)
Current Assets 流動資産	現金及び預金 Cash and cash equivalents	40,080	36,782	54,541	55,384
	売上債権※1 Accounts Receivable※1	43,403	42,801	39,809	37,036
	在庫 Inventories	53,482	67,225	69,513	68,837
	その他 Others	7,005	7,022	5,477	3,907
	合計 Total	143,972	153,831	169,341	165,166
固定資産合計 Total Fixed Assets		65,060	71,693	68,610	73,249
総資産 Total Assets		209,032	225,524	237,952	238,415
Current Liabilities 流動負債	買入債務※2 Accounts Payable※2	22,359	17,845	16,665	16,194
	その他 Others	28,588	28,156	30,268	29,940
	合計 Total	50,947	46,002	46,933	46,135
固定負債合計 Total long-term liabilities		12,057	21,094	14,789	12,276
負債合計 Total Liabilities		63,004	67,097	61,723	58,412
純資産合計 Total Net Assets		146,028	158,427	176,229	180,003
負債・純資産合計 Total Liabilities and Net Assets		209,032	225,524	237,952	238,415
有利子負債合計 Total interest-bearing debt		14,191	25,171	20,084	17,282
自己資本比率 Equity Ratio(%)		69.0%	69.4%	73.2%	74.8%
自己資本利益率 ROE(%)		17.3%	12.9%	15.5%	-

※1: 電子記録債権、契約資産を含む
Incl. Electronically recorded monetary claims

※2: 電子記録債務を含む
Incl. Electronically recorded obligations-operating

Supplementary Data - 各種費用, キャッシュフロー/ Expenses and Cash

(百万円) (Million Yen)	2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期 FY2024/3	2025年3月期 FY2025/3	2026年3月期(2Q末) FY2026/3(2Q)
研究開発費 R&D expenses	8,542	9,042	10,354	5,531
設備投資 Capex	9,725	11,602	10,245	6,905
減価償却費 (のれんの償却を除く) Depreciation (excl. Amortization of goodwill)	3,832	4,673	5,105	2,657

(百万円) (Million Yen)	2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期 FY2024/3	2025年3月期 FY2025/3	2025年3月期(2Q末) FY2026/3 2Q
営業活動によるキャッシュフロー Cash flows from operating activities	1,000	4,892	28,824	16,837
投資活動によるキャッシュフロー Cash flows from investing activities	-8,421	-10,563	2,541	-7,337
フリーキャッシュフロー Free cash flows	-7,421	-5,671	31,365	9,500
財務活動によるキャッシュフロー Cash flows from financing activities	-2,174	1,616	-13,991	-8,498
現金及び現金同等物に係る換算差額等 Adjustments	625	755	404	-158
現金及び現金同等物の期末残高 Cash and cash equivalents at the end of year	40,036	36,736	54,516	55,359

(人数) (# of People)	2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期 FY2024/3	2025年3月期 FY2025/3	2026年3月期(2Q末) FY2026/3(2Q)
正社員合計 Total regular employees	2,468	2,658	2,767	2,891
臨時従業員 年間平均雇用人員数 (※1) Average number of part-time employees, not included in the above figure	1,258	1,225	1,258	1,310
従業員合計 (※1) Number of employees	3,726	3,883	4,025	4,201

20

@ TOKYO SEIMITSU

※1: 従前の補足資料では、臨時従業員数の期末の実数を表記しておりましたが、年間平均数に改めております。また従業員合計は、正社員合計人数と、期間平均臨時従業員数の単純合算です。
In previous supplementary documents, the number of temporary employees was given as the actual number at the end of each fiscal term. However, this has been revised to the average number for each period. Therefore, "Number of employees" is a simple sum of the total number of regular employees and the average number of temporary employees during the period.

ACCURETECH | 東京精密